

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Produktbild





Der innovative Schnellanschluss - einfach, sicher und wirtschaftlich:

Leiterplatten-Klemmen mit Federanschluss in Direktstecktechnik (PUSH IN). Ein Meilenstein in der Anschlusstechnik.

Genial einfach und einfach genial in der Anwendung:

- massive Adern oder Leiter mit Aderendhülsen werkzeuglos anschließen und einfach lösen
- automatisch verarbeiten im Reflowprozess oder in der Dampfphase
- Potenziale und Klemmstellen eindeutig kennzeichnen durch farbige Push-Buttons

In Summe: Weltklasse beim Design-In, bei der Verarbeitung und in der Anwendungsbreite.

Vollautomatisch bestückbare Leiterplatten-Klemme für den Reflowprozess (SMD), mit PUSH IN Leiteranschlusstechnik. Leiteranschluss und Betätigungsrichtung des Schiebers aus einer Richtung (TOP).

- Massive & flexible Leiter mit AEH können einfach eingesteckt werden - fertig.
- Beim Anschluss flexibler Leiter ohne AEH wird der Betätiger zum öffnen der Klemmstelle benutzt
- Intuitive Bedienung durch eindeutige Unterscheidung von Leitereinführung und Betätiger.
- Verpackung in Tape on Reel























Leiterabgangsrichtung in 135° Ausführung

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 4, 135°, schwarz, PUSH IN, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tape
BestNr.	<u>1473330000</u>
Тур	LSF-SMD 3.50/04/135 SN BK RL
GTIN (EAN)	4050118279634
VPE	210 Stück
Produkt-Kennzahlen	IEC: 320 V / 12 A / 0.2 - 1.5 mm ² UL: 300 V / 12 A / AWG 28 - AWG 14
Verpackung	Tape



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	14,7 mm	Breite (inch)	0,579 inch
Höhe	14,45 mm	Höhe (inch)	0,569 inch
Höhe niedrigstbauend	14,45 mm	Nettogewicht	4,25 g
Tiefe	12,7 mm	Tiefe (inch)	0,5 inch

Temperaturen

Dauergebrauchstemperatur, max. 120 °C

Systemkennwerte

Produktfamilie	OMNIMATE Signal - Serie	Leiteranschlusstechnik	
	LSF		PUSH IN
Montage auf der Leiterplatte	SMD-Lötanschluss	Leiterabgangsrichtung	135°
Raster in mm (P)	3,5 mm	Raster in Zoll (P)	0,138 inch
Polzahl	4	Polreihenzahl	1
Kundenseitig anreihbar	Nein	Koplanarität	100 μm
Anzahl Lötstifte pro Pol	2	Abisolierlänge	8 mm
L1 in mm	10,5 mm	L1 in Zoll	0,414 inch
Berührungsschutz nach DIN VDE O	0470	Berührungsschutz nach DIN VD	E 57
-	IP 20	106	fingersicher
Durchgangswiderstand	1,60 mΩ		

Werkstoffdaten

Isolierstoff	LCP GF	Farbe	schwarz
Farbtabelle (ähnlich)	RAL 9011	Isolierstoffgruppe	IIIa
Kriechstromfestigkeit (CTI)	≥ 175	Moisture Level (MSL)	1
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Kontaktmaterial	Cu-Leg
Schichtaufbau - Lötanschluss	46 µm Sn matt	Lagertemperatur, min.	-40 °C
Lagertemperatur, max.	70 °C	Betriebstemperatur, min.	-50 °C
Betriebstemperatur, max.	120 °C	Temperaturbereich Montage, min.	-30 °C
Temperaturbereich Montage, max.	120 °C		

Anschließbare Leiter

Klemmbereich, min.	0,13 mm ²
Klemmbereich, max.	1,5 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.	AWG 28
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 14
eindrähtig, min. H05(07) V-U	0,2 mm ²
eindrähtig, max. H05(07) V-U	1,5 mm ²
feindrähtig, min. H05(07) V-K	0,2 mm ²
feindrähtig, max. H05(07) V-K	1,5 mm ²
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, mir	n. 0,25 mm ²
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4,	0,75 mm ²
max.	
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1,	0,25 mm ²
min.	

mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, 1,5 mm² max.



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Klemmbare Leiter	Leiteranschlussquerschnitt	Тур	feindrähtig
		nominal	0,25 mm ²
	Aderendhülse	Abisolierlänge	nominal 10 mm
		Empfohlene Aderendhülse	H0,25/12 HBL
	Leiteranschlussquerschnitt	Тур	feindrähtig
		nominal	0,34 mm ²
	Aderendhülse	Abisolierlänge	nominal 10 mm
		Empfohlene Aderendhülse	H0,34/12 TK
	Leiteranschlussquerschnitt	Тур	feindrähtig
		nominal	0,5 mm ²
	Aderendhülse	Abisolierlänge	nominal 10 mm
		Empfohlene Aderendhülse	H0,5/14 OR
	Leiteranschlussquerschnitt	Тур	feindrähtig
		nominal	0,75 mm ²
	Aderendhülse	Abisolierlänge	nominal 10 mm
		Empfohlene Aderendhülse	H0,75/14T HBL
	Leiteranschlussquerschnitt	Тур	feindrähtig
		nominal	1,5 mm ²
	Aderendhülse	Abisolierlänge	nominal 7 mm
		Empfohlene Aderendhülse	H1.5/7
Hinweistext	Die Länge der Aderendhülse ist in Abhä Bemessungsspannung auszuwählen., D größer als das Raster (P) sein.		

Bemessungsdaten nach IEC

geprüft nach Norm		Bemessungsstrom, min. Polzahl	
	IEC 60664-1, IEC 61984	(Tu=20°C)	12 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl		Bemessungsstrom, min. Polzahl	
(Tu=20°C)	12 A	(Tu=40°C)	12 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl		Bemessungsspannung bei	
(Tu=40°C)		Überspannungsk./Verschmutzungsgra	ad
	12 A	II/2	320 V
Bemessungsspannung bei		Bemessungsspannung bei	
Überspannungsk./Verschmutzungs	grad	Überspannungsk./Verschmutzungsgra	nd
III/2	160 V	III/3	160 V
Bemessungsstoßspannung bei		Bemessungsstoßspannung bei	
Überspannungsk./Verschmutzungs	grad	Überspannungsk./Verschmutzungsgra	ad
II/2	2,5 kV	III/2	2,5 kV
Bemessungsstoßspannung bei		Kurzzeitstromfestigkeit	
Überspannungsk./Verschmutzungs	grad	•	
III/3	2,5 kV		3 x 1s mit 80 A



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Nenndaten nach CSA

Institut (CSA)	(1)	Zertifikat-Nr. (CSA)	
	•		200039-1664286
Nennspannung (Use group B / CSA)	300 V	Nennspannung (Use group D / CSA)	300 V
Nennstrom (Use group B / CSA)	10 A	Nennstrom (Use group D / CSA)	10 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.	AWG 28	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 14
Hinweis zu den Zulassungswerten	Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs- Zertifikat.		

Nenndaten nach UL 1059

Institut (cURus)	c Al us	Zertifikat-Nr. (cURus)	E60693
Nennspannung (Use group B / UL 1059)	300 V	Nennspannung (Use group D / UL 1059)	300 V
Nennstrom (Use group B / UL 1059)	12 A	Nennstrom (Use group D / UL 1059)	10 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.	AWG 28	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 14
Hinweis zu den Zulassungswerten	Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs- Zertifikat.		

Verpackungen

Verpackung	Tape	VPE Länge	40 mm
VPE Breite	330 mm	VPE Höhe	330 mm
Tapetiefe (T2)	15,7 mm	Tapebreite (W)	32 mm
Tape-Taschentiefe (K0)	15,2 mm	Tape-Taschenhöhe (A0)	11,3 mm
Tape-Taschenbreite (B0)	19,49 mm	Tape-Taschenabstand (P1)	20 mm
Tape-Lochabstand (E)	1,75 mm	Tape-Taschenabstand (F)	14,2 mm
Tape-Spulendurchmesser Ø (A)	330 mm	Oberflächenwiderstand	$Rs = 10^9 - 10^{12} \Omega$

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002643	ETIM 7.0	EC002643
ECLASS 9.0	27-44-04-01	ECLASS 9.1	27-44-04-01
ECLASS 10.0	27-44-04-01	ECLASS 11.0	27-46-01-01



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Wichtiger Hinweis

Triontigor Illitrois	
IPC-Konformität	Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt
	und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative
	Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 "Class2". Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte
	können auf Anfrage bewertet werden.
Hinweise	Weitere Farben des Schiebers auf Anfrage
	Betätigungskraft des Schiebers max. 40 N
	Bemessungsstrom bezogen auf Bemessungsquerschnitt und min. Polzahl
	AEH mit Kunststoffkragen nach DIN 46228/4
	AEH ohne Kunststoffkragen nach DIN 46228/1
	• Zeichnungsangabe P = Raster
	Bemessungsdaten sind bezogen auf das jeweilige Bauteil. Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind
	entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten.
	 Crimpform "A" für Aderendhülsen mit Crimpwerkzeug PZ 6/5 empfohlen.
	Langzeitlagerung des Produkts mit einer durchschnittlichen Temperatur von 50 °C und einer Langzeitlagerung des Produkts mit einer durchschnittlichen Temperatur von 50 °C und einer
	durchschnittlichen Luftfeuchtigkeit von 70%, 36 Monate

Zulassungen

Zulassungen	⊕ c 51 2 us Ⅲ @
	— U # — U3 iiii —

ROHS	Konform
UL File Number Search	E60693

Downloads

Zulassung / Zertifikat /				
Konformitätsdokument	Declaration of the Manufacturer			
Engineering-Daten	<u>STEP</u>			
Engineering-Daten	EPLAN, WSCAD			



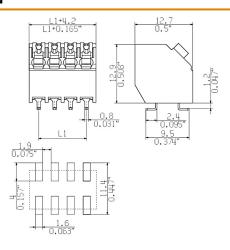
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

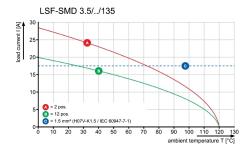
www.weidmueller.com

Zeichnungen

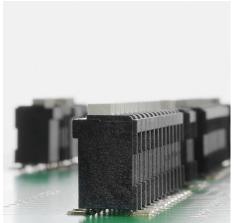
Maßbild



Diagramm

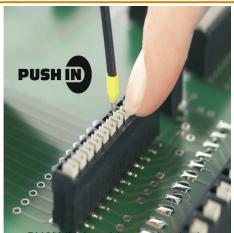


Produktvorteil



Stabile Lötanschlüsse

Produktvorteil



PUSH IN-Anschlusstechnologie



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

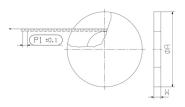
www.weidmueller.com

Zeichnungen

Produktvorteil

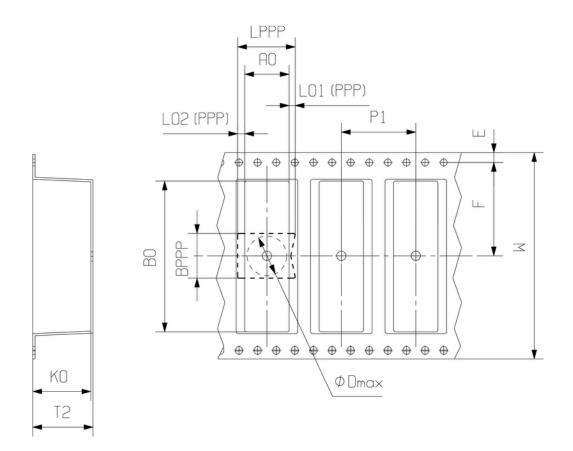


Maßbild



Verpackt in Tape-on-Reel

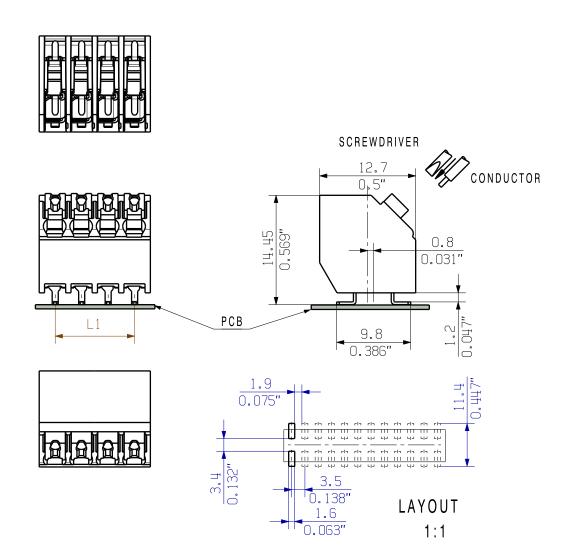
Maßbild



DIRECTION OF UNREELING



(



For the mounting on PCBs, it should be noted that the rated data relates only to the PCB components alone.

The neccessary creepage and clearance paths must be observed in the relevnt equipment standards in accordance with IEC 664 / VDE 0110.

The current-carrying capacity and pitch tolerance is to be determined according to DIN IEC 326 part 3.

Weidmüller PCB components are rated in accordance with the DIN EN 61984 standard, and are valid for its field of application. If the components are used in accordance with the intended purpose, the components will meet all requirements with respect to the occurring of electrical, mechanical, thermic and corrosive stress.

SHOWN: ISE-SMD 3 50/04/135

12	38,5	1,516
11	35,0	1,378
10	31,5	1,240
9	28,0	1,102
8	24,5	0,965
7	21,0	0,827
6	17,5	0,689
5	14,0	0,551
4	10,5	0,413
3	7,0	0,276
2	3,5	0,138
n	L1 [mm]	L1 [Inch]

011031VE 311633. n L1 [mm] L1				
DOMS				· CAT.NO.:. ·
DIN ISO 2768-m	86128/5 25.01.16 KR	UG_M 01	We	Pidmüller C 57457 04 DRAWING NO. ISSUE NO. SHEET 01 OF 04 SHEETS
		DATE	NAME	
	DRAWN	03.06.2015	KRUG_M	LSF-SMD 3.50//135
	RESPONSIBLE		KRUG_M	LEITERPLATTENKLEMME
SCALE: 2:1	CHECKED	02.02.2016	HELIS_MA	PCB TERMINAL
SUPERSEDES: .	APPROVED		LANG_T	PRODUCT FILE: LSF-SMD 3.50 7358



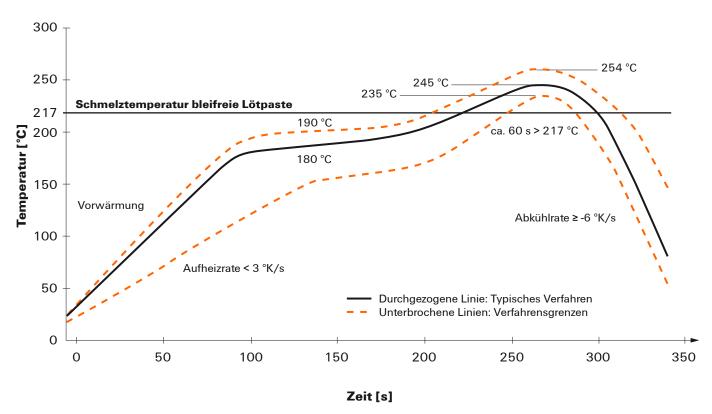


Empfohlenes Reflow-Lötprofil

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16 D-32758 Detmold Germany

Fon: +49 5231 14-0 Fax: +49 5231 14-292083 www.weidmueller.com



Reflow Lötprofil

Das ideale Temperaturprofil für die Surface Mount Technology (SMT) ist eine häufig gestellte Frage in der Produktionswelt. Eine eindeutige Antwort gibt es nicht. Der Temperatur-Zeit-Verlauf ist abhängig von den Verarbeitungseigenschaften der Lotpaste und den Belastungsgrenzen der Bauelemente.

Folgende Parameter sind zu berücksichtigen:

- Vorheizzeit
- Maximale Temperatur
- Zeit oberhalb des Pasten-Schmelzpunktes
- Abkühlzeit
- maximaler Aufheizgradient
- minimaler Abkühlgradient

Das von uns empfohlene Lötprofil beschreibt den typischen Verlauf sowie die Prozessgrenzen. In der Vorheizphase werden Platine und Bauelemente schonend vorgeheizt. Der Aufheizgradient beträgt ≤ +3 K/s. Parallel dazu wird die Lotpaste 'aktiviert'. In der Zeit oberhalb der Schmelztemperatur 217 °C wird das Lot flüssig, verbindet die Bauelemente mit den Anschlüsse auf der Platine. Dabei wird die maximale Temperatur von 245 °C bis 254 °C zwischen 10 und 40 Sekunden gehalten. In der Abkühlzeit bei ≥ -6 K/s härtet das Lot aus. Platine und Bauelemente werden nicht zu rasch abgekühlt, um Spannungsrisse zu vermeiden.